

RESINFLOOR TW

Sottofondo a rivestimento di ponte resinoso

Il **RESINFLOOR TW** è un sottofondo di livellamento di ponte ("Primary deck covering") applicato a spatola, a base di resina epossidica ed inerti leggeri. Può essere applicato ad uno spessore variabile da 3 mm. a 20 mm. Particolarmente idoneo per ponti esterni e locali umidi, piscine ecc. Può essere fornito in formulazione tissotropica per livellamento di superfici verticali.

UTILIZZO

- ✓ Come sottofondo di livellamento per ponti esterni e paratie prima della posa dei mantelli di copertura.
- ✓ Per riempimenti ad alto spessore e basso peso.
- ✓ Per creare le idonee pendenze agli scarichi.
- ✓ Particolarmente idoneo come sottofondo di piscine e locali umidi.

DATI TECNICI

- Omologazioni
 - R.I.NA.: "Non Facilmente Infiammabile" – IMO RES. A.653(16)
 - R.I.NA.: "Emissione di Fumi Tossici" – IMO RES. 61(67)
- Spessore: *da 3 mm. a 20 mm.*
- Peso: M. V.: *0,86 gr/cm³*
- Resistenza a Flessione (Flexural strength - ASTM D-790) : *111 MPa*
- Resistenza a Trazione: (Tensile strength – ASTM C-638) : *23 MPa*
- Resistenza a compressione (Compressive strength yield – ASTM D-695) : *30 MPa*
- Durezza (Hardness – ASTM D-2240) : *Shore "D" 85*
- Forza Adesiva (su acciaio) : *> 2,5 Mpa*

VANTAGGI

- ❖ Protezione assoluta della lamiera dalla corrosione.
- ❖ Forte adesione.
- ❖ Resiliente e sufficientemente elastico.
- ❖ Ritardante al fuoco.
- ❖ Durata enormemente superiore a quella dei tradizionali sottofondi livellanti.

APPLICAZIONE

- Discatura (Picchettaggio ed Impallinatura su superfici corrose); sgrassaggio della lamiera.
- Applicazione di primer per lamiere.
- Applicazione di una mano di ancoraggio se necessaria.
- Applicazione a spatola del sottofondo **RESINFLOOR TW**
- Applicazione di rasatura, se necessaria.